

## SC-SMT 3.81/05/270G 1.5SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

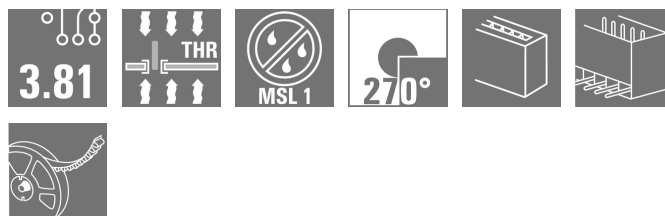
Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



270° 取り出し方向の SC-SMT ピンヘッダー：270° の角度は、差し込み接続方向およびソルダーピンの間に該当します。プラグ接続方向は、基板に対して平行です。ただし、ソケットブロックは基板に対して反転平行のプラグ接続角度を有します。

- 部品および装置設計時の自由度が高くなります。
- 複数のプリント基板による単体ハウジング内の並列配置での高い部品密度
- 電線取出し方向を任意に選択できるため、用途に応じたハウジング設計が可能です。
- サイドクロース (G)、およびねじフランジ (F) のバージョンが使用可能。
- ピンの長さは 1.5 mm または 3.2 mm です

ワイドミュラー 3.81mm ピッチ (0.15 インチ) プラグインコネクタは、標準的な同タイプのコネクタとレイアウトの互換性があります。マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

## 一般注文データ

バージョン	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THRはんだ接続, 3.81 mm, 極数: 5, 270°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫メッキ, 黒色, Tape
注文番号	<a href="#">2457550000</a>
種別	SC-SMT 3.81/05/270G 1.5SN BK RL
GTIN (EAN)	4050118472721
数量	400 Stück
製品データ	IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 11 A
パッケージ	Tape

## SC-SMT 3.81/05/270G 1.5SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	9.2 mm	奥行き (インチ)	0.362 inch
高さ	8.6 mm	高さ (インチ)	0.339 inch
下位バージョンの高さ	7.1 mm	幅	20.44 mm
幅 (インチ)	0.805 inch	正味重量	1.981 g

## システム仕様

製品ファミリー	OMNIMATE信号 - BC/SC 3.81シリーズ	接続方式	基板接続
PCB の取り付け	THT/THRはんだ接続	ピッチ (mm) (P)	3.81 mm
ピッチ (インチ) (P)	0.15 "	外向きエルボ	270°
極数	5	極当たりソルダーピン数	1
ソルダーピン長 (l)	1.5 mm	ソルダーピン長 公差	+0,02 / -0,02 mm
はんだピン寸法	d = 1.0 mm, 八角形	はんだピンの寸法= d公差	0 / -0,03 mm
ソルダーアイレット穴直径 (D)	1.3 mm	ソルダーアイレット穴直径公差 (D)	+0.1 mm
はんだパッドの外径	2.1 mm	テンプレート開口径	1.9 mm
L1 (mm)	15.24 mm	L1 (インチ)	0.6 "
行数	1	ピンモデルシリーズ数量	1
DIN VDE 57 106に適合したタッチセーフ保護	フィンガーセーフプラグ抜き/バックオブハンドセーフのプラグ差込	DIN VDE 0470に適合したタッチセーフ保護	IP20接続/IP10接続解除
体積抵抗	≤5 mΩ	コーディング可能	はい

## 材料データ

絶縁材	LCP GF	色	黒色
カラーチャート (類似)	RAL 9011	絶縁材グループ	IIIa
比較追跡指数 (CTI)	≥ 175	Moisture Level (MSL)	1
UL 94 可燃性等級	V-0	接点材質	銅合金
接触表面	錫メッキ	保管温度、最小	-40 °C
保管温度、最大	70 °C	動作温度、最小	-50 °C
動作温度、最大	120 °C	温度範囲、設置、最小	-25 °C
温度範囲、設置、最大	120 °C		

## IEC規格に準拠した公称データ

標準に準拠して検査済	IEC 60664-1, IEC 61984	定格電流、最小極数 (Tu=20°C)	17.5 A
定格電流、最大極数 (Tu=20°C)	17 A	定格電流、最小極数 (Tu=40°C)	17.5 A
定格電流、最大極数 (Tu=40°C)	15.1 A	サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 II/2	320 V
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/2	160 V	サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/3	160 V
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 II/2	2.5 kV	サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/2	2.5 kV
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/3	2.5 kV	短時間耐電流抵抗	3 x 1sで76 A

## CSAに準拠した公称データ

定格電圧 (グループ B/CSA 使用)	300 V	定格電流 (グループ B/CSA 使用)	11 A
----------------------	-------	----------------------	------

## UL 1059に準拠した公称データ

定格電圧 (グループ B / UL 1059 使用)	300 V	定格電圧 (グループ D / UL 1059 使用)	300 V
定格電流 (グループ B / UL 1059 使用)	11 A	定格電流 (グループ D / UL 1059 使用)	11 A

作成日 2024/07/12 18:16:42 CEST

## SC-SMT 3.81/05/270G 1.5SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 梱包

ESD レベルのパッケージ	静電気散逸	パッケージ	Tape
VPE 長	330 mm	VPE幅	330 mm
VPEの高さ	50 mm	テープの深さ (T2)	11.1 mm
テープ幅 (W)	44 mm	テープポケットの深さ (K0)	10.6 mm
テープポケットの高さ (A0)	9.5 mm	テープポケット幅 (B0)	33.2 mm
テープポケットの分離 (P1)	16 mm	テープホルルの分離 (E)	1.75 mm
テープポケットの分離 (F)	20.2 mm	テープリール径 (A)	330 mm
表面抵抗	$R_s = 10^9 - 10^{12} \Omega$		

## 分類

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01
ECLASS 12.0	27-46-02-01	ECLASS 13.0	27-46-02-01

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

## 重要なメモ

IPC準拠	適合性：製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行なわれ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。
注意事項	<ul style="list-style-type: none"><li>• 要求に応じて追加のバリエーション</li><li>• 定格断面積および最小値に関連する定格電流極数。</li><li>• 公称データは、コンポーネント自体のみを指します。他のコンポーネントとのクリアランスおよび沿面距離は、関連する適用規格に従って設計する必要があります。</li><li>• 図面上のP = ピッチ</li><li>• OMNIMATE コネクタは IEC 61984 に準拠した切断容量 (COC) のないコネクタです。指定された使用中、活性化中や負荷がかかっているときにコネクタを抜き差しすることはできません</li><li>• 平均温度 50 °C、最大湿度 70%、36ヶ月の長期保存が可能</li></ul>

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
製品変更通知	<a href="#">Changeover to ESD bags for "Tape on Reel" products</a> <a href="#">Umstellung auf ESD-Beutel bei „Tape on Reel“ Produkten</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	<a href="#">FL DRIVES EN</a> <a href="#">FL DRIVES DE</a>
ホワイトペーパーの表面取り付け技術	<a href="#">Download Whitepaper</a>

作成日 2024/07/12 18:16:42 CEST

**SC-SMT 3.81/05/270G 1.5SN BK RL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

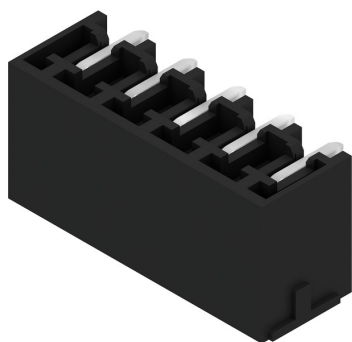
D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

製品イメージ



## Recommended wave soldering profiles

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Single Wave:



### Double Wave:



### Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.

## Recommended reflow soldering profile

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



## Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically  $\leq +3\text{K/s}$ . In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at  $\geq -6\text{K/s}$  solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.